

ICT活用工事対象工種拡大

【従 前】

【ICT活用工事:路盤工】

- i) 新設道路の車道部の施工
 - ii) 路盤・路床面の等の不陸整正
 - iii) 一層当りの仕上り層が20cmまでの下層路盤
 - iv) 一層当りの仕上り層が15cmまでの上層路盤
- ※上記は3D-MCモータグレーダによる施工
施工プロセス①~⑤(当分の間①~③でも可)

【ICT活用工事:土工】

- i) 掘削
 - ii) 路体(築堤)盛土
 - iii) 路床盛土
 - iv) 法面整形
- 施工プロセス①~⑤(当分の間①~③でも可)

『関連施工で実施』

- 【ICT活用施工(作業土工(床堀))】
施工プロセス①~⑤(当分の間①~③でも可)
- 【ICT活用施工(付帯構造物設置工)】
 - i) コンクリートブロック工
 - ii) 側溝工施工プロセス①~⑤(当分の間①②でも可)
※ICT建機による施工は対象外
- 【ICT活用施工(法面工)】
 - i) 植生工
 - ii) 吹付工施工プロセス①~⑤(当分の間①②でも可)
※ICT建機による施工は対象外

【ICT活用工事:地盤改良工】

- i) 河川土工、海岸土工
 - ii) 道路土工
- 路床安定処理、表層安定処理
固結工(中層混合処理)
施工プロセス①~⑤(当分の間①~③でも可)

【ICT活用工事:河川浚渫工】

- i) 浚渫工(バックホウ浚渫船)
- 施工プロセス①~⑤(当分の間①~③でも可)

【ICT活用工事:路盤工】

- i) 新設道路の車道部の施工
 - ii) 路盤・路床面の等の不陸整正
 - iii) 一層当りの仕上り層が20cmまでの下層路盤
 - iv) 一層当りの仕上り層が15cmまでの上層路盤
- ※上記は3D-MCモータグレーダによる施工
施工プロセス①~⑤(当分の間**3つ以上のプロセス**でも可)

【ICT活用工事:土工】

- i) 掘削
 - ii) 路体(築堤)盛土
 - iii) 路床盛土
 - iv) 法面整形
- 施工プロセス①~⑤(当分の間**3つ以上のプロセス**でも可)

『関連施工で実施』※関連施工のみの実施は認めない。

- 【ICT活用施工(作業土工(床堀))】
- 【ICT活用施工(付帯構造物設置工)】
 - i) コンクリートブロック工
 - ii) 側溝工※ICT建機による施工は対象外
- 【ICT活用施工(法面工)】**工種の追加**
 - i) 植生工
 - ii) 吹付工
 - iii) 吹付法砕工(追加)**※ICT建機による施工は対象外

【注意事項】

○ICT土工の関連施工

- ・ICT作業土工(床堀)、 ・ICT付帯構造物設置工、 ・ICT法面工、
ICT活用工事(土工)に併せ、関連施工について受注者と協議を行い、整った場合に実施する。

○成績評定

- ※ICT活用工事(施工プロセス)を有効に実施したことが認められた場合は、実施した範囲により工事成績の「創意工夫」の項目で加点評価及び「施工管理」の「その他」項目で評価するものとする。

○実施証明書

- ※ICT活用工事において、**3つ以上の施工プロセスの実施が認められる工事については、施工プロセス①~⑤の実施範囲により、ICT活用工事実施証明書を発行する。**

【改 正】

赤書:令和2年度改正

【ICT活用工事:地盤改良工】**工種の追加**

- i) 河川土工、海岸土工
 - ii) 道路土工
- 路床安定処理、表層安定処理
固結工(中層混合処理、**スラリー攪拌工(追加)**)
施工プロセス①~⑤
(当分の間**3つ以上のプロセス**でも可)

【ICT活用工事:河川浚渫工】

- i) 浚渫工(バックホウ浚渫船)
- 施工プロセス①~⑤
(当分の間**3つ以上のプロセス**でも可)

【ICT活用工事:舗装工(修繕工)】:追加

- i) 路面切削工
- 施工プロセス①~⑤
※当分の間**3つ以上の施工プロセス**でも可

「ICT活用工事」の定義

- 施工プロセスの全段階においてICT施工技術を全面的に活用する工事
- ① 3次元起工測量
 - ② 3次元設計データ作成
 - ③ ICT建機による施工
 - ④ 3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤ 3次元データの納品